

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1300号）核准，公司2020年7月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股10,000,000股，发行价为48.47元/股，募集资金总额为人民币48,470万元，根据有关规定扣除发行费用人民币4,351.60万元（不含税）后，实际募集资金金额为44,118.40万元。该募集资金已于2020年7月17日到账。上述资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月20日出具天职业字[2020]32804号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024年半年度，公司募集资金使用情况为：公司累计直接投入募集资金项目42,320.69万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为1,798.34万元，募集资金专用账户利息收入975.54万元，部分募投项目结项后补充流动资金322.51万元，募集资金专户2024年6月30日结余合计为2,451.37万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

本公司董事会批准开设了建设银行合肥青年路支行（以下简称“青年路支行”）

34050145470800001828、中国银行股份有限公司重庆北碚支行（以下简称“北碚支行”）111674531230、北碚支行 113074526840 三个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2021年1月14日，公司、公司之子公司博讯光电科技（合肥）有限公司（以下简称“博讯光电”）与青年路支行和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署《募集资金四方监管协议》，在青年路支行开设募集资金专项账户（账号：34050145470800001828）。

2021年4月13日，公司、公司之子公司重庆翰博显示科技有限公司（以下简称“重庆翰博显示”）、重庆翰博显示科技研发中心有限公司（以下简称“重庆翰博显示研发中心”）分别与北碚支行和中信建投证券签署《募集资金四方监管协议》，在北碚支行开设募集资金专项账户（账号：111674531230、113074526840）。

2023年5月9日，公司、公司之子公司博讯光电与青年路支行和华泰联合证券重新签署《募集资金三方监管协议》；公司、公司之子公司重庆翰博显示、重庆翰博显示研发中心分别与北碚支行和华泰联合证券重新签署《募集资金三方监管协议》，募集资金专户均未发生变化。

截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币 万元

银行名称	银行账号	余额
中国建设银行合肥青年路支行	34050145470800001828	2,451.37
中国银行股份有限公司重庆水土支行	111674531230	0
中国银行股份有限公司重庆水土支行	113074526840	0
合计		2,451.37

注：中国银行股份有限公司重庆水土支行为北碚支行的二级支行

三、2024年1-6月募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2024年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币42,320.69万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募投项目实施地点和实施方式的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（五）节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目：“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”已完成结项，为提高资金使用效率，公司将上述项目节余募集资金320.07万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-028）

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为2,451.37万元，均存放于公司在银行开立的募集资金专用帐户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

前期变更募集资金投资项目的情况如下：公司于2021年3月26日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，于2021年4月13日召开2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，中信建投证券出具了核查意见。具体内容详见公司2021年3月29日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《翰博高新材料（合肥）股份有限公司变更募集资金用途公告》及相关公告；公司决定将原募集资金投资项目“有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目”暂未使用的募集资金14,092.04万元（其中本金14,000.00万元，利息92.04万元）用于本次新增募投项目“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”。

截至2024年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表

附表2：2024年1-6月变更募集资金投资项目情况表

翰博高新材料（合肥）股份有限公司
董事会
2024年8月29日

附表 1:

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		48,470.00				本年度投入募集资金总额	428.09			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	42,320.69			
累计变更用途的募集资金总额		14,092.04								
累计变更用途的募集资金总额比例		29.07%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目	是	8,000.00	8,000.00	286.50	7,790.17	97.38	2024-2-29	0	否	否
2、重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目	是	6,092.04	6,092.04	-	6,287.99	103.22	2024-2-29	0	不适用	否
3、背光源智能制造及相关配套设施建设项目	否	14,192.40	14,192.40	141.59	12,288.97	86.59	2024-9-30	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	15,926.00	15,926.00	-	15,953.56	100.17	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		44,210.44	44,210.44	428.09	42,320.69					
合计		44,210.44	44,210.44	428.09	42,320.69					

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》：在募投项目实施主体、实施方式、资金用途和投资总额均不发生变化的情况下，将“背光源智能制造及相关配套设施建设项目”、“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”的预定可使用状态日期延期至 2024 年 9 月 30 日。</p> <p>其中“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”已于 2024 年 2 月 29 日达到预期可使用状态，公司已于 2024 年 4 月 26 日披露了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号 2024-028）。</p> <p>“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”未达到预计收益的原因主要系项目尚处于正式投产准备阶段；“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”未达到预计收益的原因主要系项目为研发中心建设，不涉及产品生产和销售。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>公司于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金使用方式的议案》：根据募集资金投资项目实施的客观需要，为了简化募集资金投入程序、加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，在募集资金投资项目实施主体、项目用途等不变的情况下，公司变更募集资金使用方式，将募集资金 14,192.4 万元（该金额不包含已产生的利息）以增资形式用于实施背光源智能制造及相关配套设施建设项目，暨对博讯光电科技（合肥）有限公司进行增资。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>公司募集资金投资项目“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”已结项，为提高资金使用效率，公司将上述项目节余募集资金 320.07 万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-028）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 2,451.37 万元，均存放于公司在银行开立的募集资金专用帐户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2:

2024 年 1-6 月变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目	有机发光半导体 (OLED) 制造装置零部件剥	8,000.00	286.50	7,790.17	97.38	2024-2-29	0	否	否
重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目	离、精密再生及热喷涂 (二期)	6,092.04	-	6,287.99	103.22	2024-2-29	不适用	不适用	否
合计	-	14,092.04	286.50	14,078.16	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)					为应对日益变化的市场环境, 公司将用新项目扩大公司产能, 延伸产业链条, 提升公司科研实力, 增强公司经营能力和竞争力。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)					<p>公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议, 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》: 在募投项目实施主体、实施方式、资金用途和投资总额均不发生变化的情况下, 将“背光源智能制造及相关配套设施建设项目”、“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”的预定可使用状态日期延期至 2024 年 9 月 30 日。</p> <p>其中“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”已于 2024 年 2 月 29 日达到预期可</p>				

	<p>使用状态，公司已于 2024 年 4 月 26 日披露了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号 2024-028）。</p> <p>“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”未达到预计收益的原因主要系项目尚处于正式投产准备阶段；“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”未达到预计收益的原因主要系项目为研发中心建设，不涉及产品生产和销售。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

注：公司于 2021 年 3 月 26 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，于 2021 年 4 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：截至 2021 年 2 月 28 日，本次涉及变更的募集资金总额为原“有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目暂未使用的募集资金 14,092.04 万元（其中本金 14,000.00 万元利息 92.04 万元）。变更的资金用于投资建设重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目、重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目。